



2023年2月27日

各 位

会 社 名 TOWA株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 岡田 博和
(コード番号 6315 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営企画本部長 中西 和彦
TEL (075) 692 - 0251

**マレーシアにおける金型製造事業譲受及び
製造子会社の設立並びに特定子会社の異動に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、K-Tool Engineering Sdn. Bhd. (マレーシア ペナン州)より同社の金型製造事業を譲り受けること、及びその受け皿となる製造子会社の設立について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当該子会社の資本金額が当社の資本金の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社に該当する予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

1. 事業譲受の理由

当社グループは、東南アジア地域において半導体製造装置の製造拠点をマレーシアに、販売拠点をシンガポール、フィリピン、タイに有し事業展開しております。近年、世界的に脱炭素に向けた取り組みが進む中、EV向けの車載用半導体や省エネルギー化に貢献するパワー半導体の需要が高まっており、これらの製品を数多く生産する東南アジア地域において関連の設備投資が加速しております。また、地政学的リスクの観点からも東南アジア地域への注目度が高まっており、同地域への半導体メーカー各社の積極的な投資は今後も続くことが予想されます。

かかる状況下、当社は、半導体製造装置事業と金型製造事業の連携による更なる事業発展・拡大のため、今般、K-Tool Engineering Sdn. Bhd. (以下、K-Tool社)の金型製造事業を譲り受けることとし、合わせてその受け皿となる製造子会社を設立することといたしました。

K-Tool社の金型製造事業部門は半導体製造用金型の専門技術者を有し、高精度な金型メーカーとして国内外の企業から認められております。高い技術力を持つ同社の従業員と既存顧客を当社が引き継ぐことで、東南アジア地域での金型事業の早期立ち上げが可能となります。また、既存拠点との連携により、半導体製造用装置と金型の設計・製造・販売の一貫体制を構築することでプロセスビジネスの展開が可能となり、半導体メーカー各社との関係が一層強固なものとなります。

2. 事業譲受の概要

(1) 譲受事業の内容

精密金型・成形金型・TF金型・スタンピング金型・金型部品等の設計、製造及び販売

(2) 当該事業部門の直前事業年度における売上高及び経常利益

売 上 高：11,007千マレーシアリングット (約3億38百万円)

※ 一部事業の譲受であり、費用の切り分けが困難であるため、売上高のみの開示としております。

(3) 譲り受ける予定の資産及び金額

譲り受ける資産は、土地、工場建屋、機械設備、備品等23,894千マレーシアリングット (約7億33百万円)です。

※ 負債の譲受はありません。

(4) 事業譲受の方法及び価格

① 譲受方法：マレーシア ペナン州に新会社（当社子会社）を設立し、当該新会社がK-Tool社から金型製造事業を譲り受ける方法により実行いたします。

② 譲受日：2023年4月（予定）

③ 譲受価格：30,000千マレーシアリングgit（約9億21百万円）

（注）円換算の金額は、1マレーシアリングgit=30.71円（2023年1月末TTM）で計算しています。

3. 相手先の概要

(1) 名 称：K-Tool Engineering Sdn. Bhd.

(2) 所在地：マレーシア ペナン州

(3) 代表者の役職・氏名：Director Tan Hoo Peng

(4) 事業内容：精密金型・成形金型・TF金型・スタンピング金型・金型部品等の設計、製造及び販売、並びに部品加工受託事業

(5) 資本金：1,000千マレーシアリングgit

(6) 設立年月日：1995年7月

(7) 純資産：8,842千マレーシアリングgit

(8) 総資産：14,846千マレーシアリングgit

(9) 当社と当該会社の関係

資本的関係：該当事項はありません。

取引関係：当社子会社の取引先（精密部品の加工委託先）です。

関連当事者への該当状況：該当事項はありません。

4. 新会社の概要

(1) 名 称：TOWA TOOL SDN. BHD.

(2) 所在地：Plot 159, Jalan Sungai Keluang, Bayan Lepas, Phase I FTZ, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia

※K-Tool社の既存工場及び設備を譲り受けて継続利用いたします。

(3) 代表者の役職・氏名：Director Chairman 西村 一洋

(4) 事業内容：半導体製造用等精密金型・成形金型・TF金型・スタンピング金型、精密加工部品の生産・販売・設計・技術サービス・アフターサービス

(5) 資本金：40,000千マレーシアリングgit（約12億28百万円）

(6) 設立日：2023年3月（予定）

(7) 出資者：TOWA株式会社100%

(8) 当初従業員：約60名

(9) 当社との関係

資本的関係：当社の特定子会社となります。

人的関係：当社の取締役が当該会社の取締役を兼任する予定です。

取引関係：当社の半導体製造用金型及び部品等の設計・生産を受託する予定です。

（注）円換算の金額は、1マレーシアリングgit=30.71円（2023年1月末TTM）で計算しています。

5. 今後の見通し

今期（2023年3月期）の業績に与える影響は軽微です。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上